

ウェーハ製造工程の課題解決を提案します

We propose solutions for your wafer manufacturing process

インゴット研削用 For ingot grinding

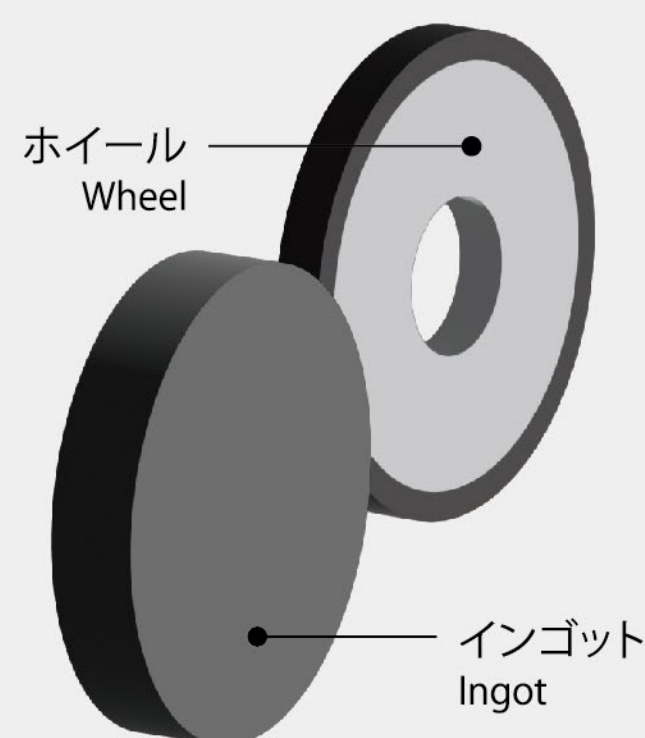
外周研削

Peripheral grinding

レジンダイヤモンドホイール

レボメイト

Resin Diamond Wheel **Revomate**



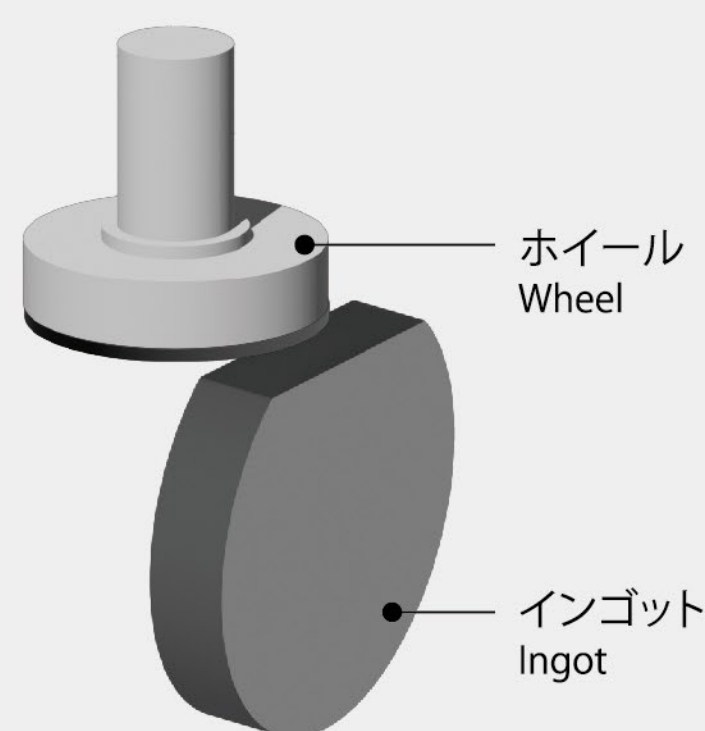
オリフラ加工

Orientation flat grinding

レジンダイヤモンドホイール

レボメイト

Resin Diamond Wheel **Revomate**



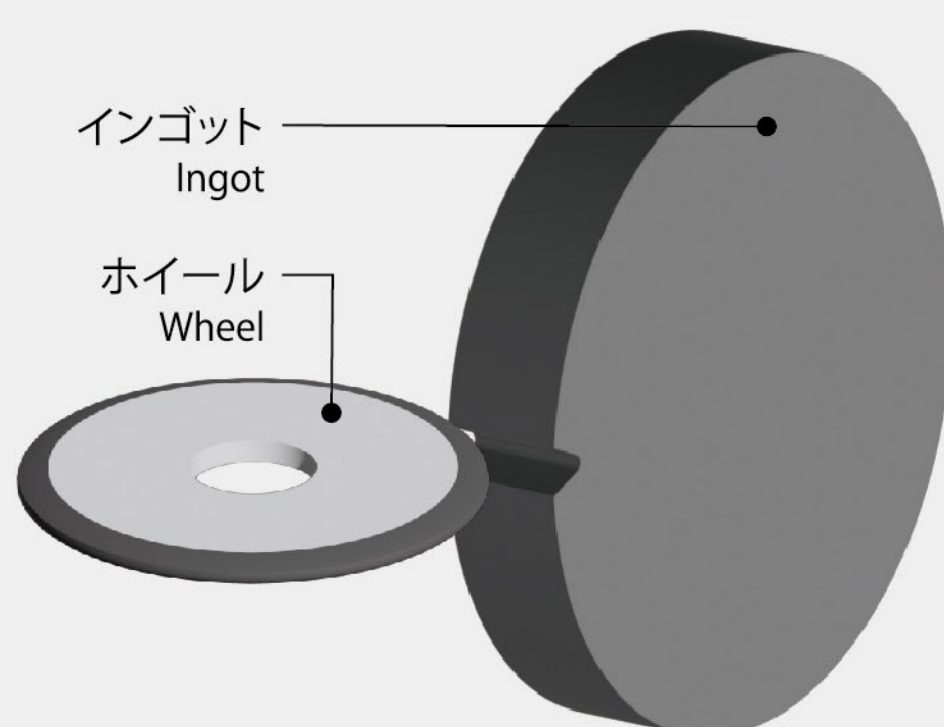
ノッチ加工

Notch grooving

メタルダイヤモンドホイール

テラメイトMT3

Metal Diamond Wheels **Teramate MT3**



加工時間を
短縮したい

Would you like to shorten
the machining time?

表面あらさを
向上させたい

Would you like to improve
surface roughness?

切込み量

2倍向上

2.0 times improvement
on cutting depth

表面あらさ

60%低減

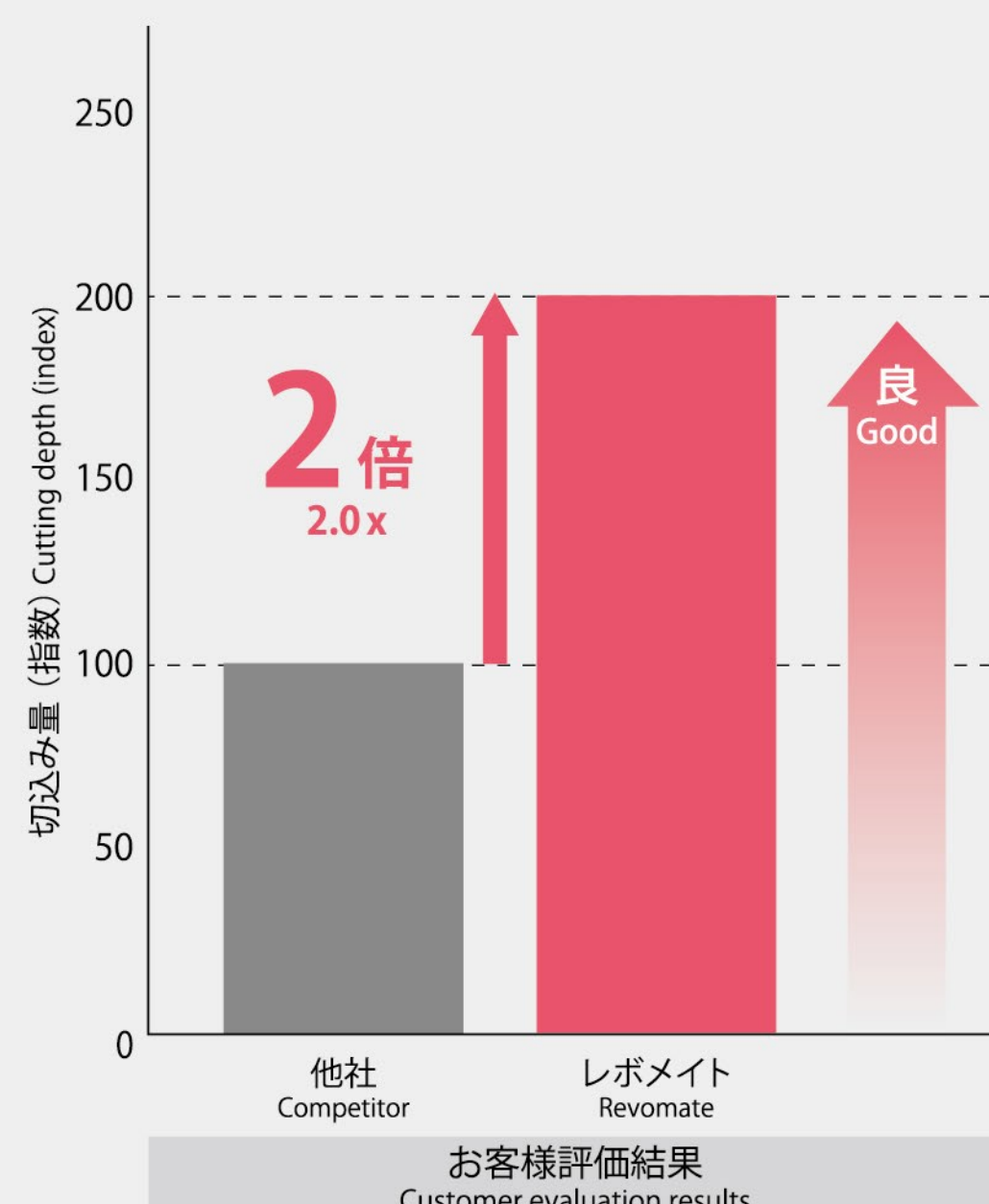
60% reduction
on surface roughness

評価事例 Evaluation example

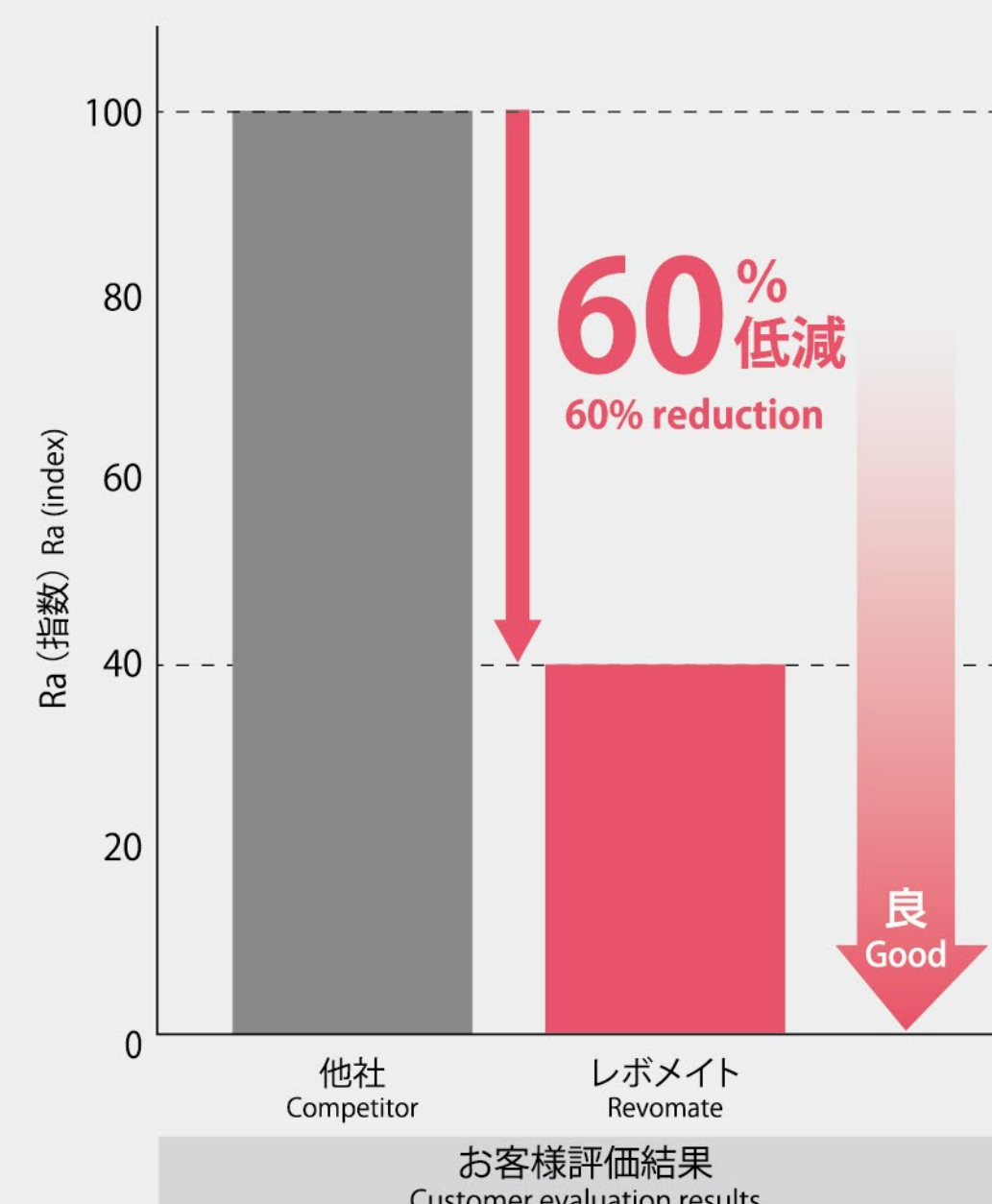
工作物 Workpiece

SiC (φ155×11T)

切込み量 比較
Cutting depth comparison



表面あらさ 比較
Surface roughness comparison



切込み量2倍向上により、
さらなる高能率加工が可能

This wheel enables more efficient machining
by doubling the cutting depth

